

V9 免洗焊锡膏

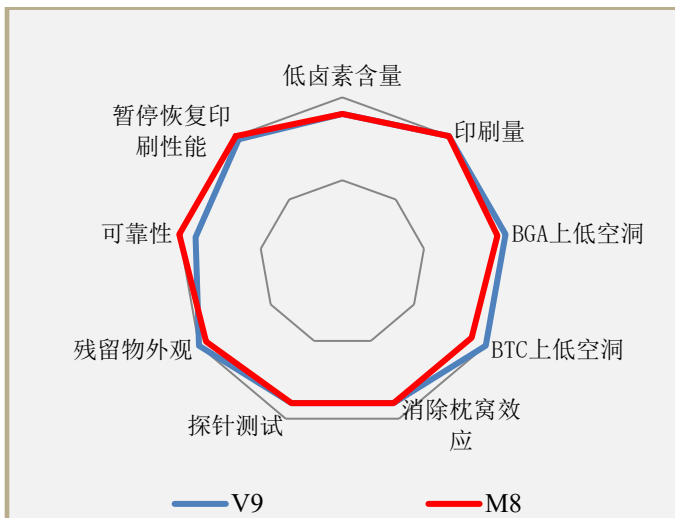
特性

- ▶ 低空洞率：BGA低至1%，BTC <5%
- ▶ 当面积比小于0.66 时，可稳定印刷
- ▶ 高绝缘阻抗性 (SIR)
- ▶ 工艺和设备配置类似M8
- ▶ 符合REACH和RoHS 标准
- ▶ 可提供SAC305 T4

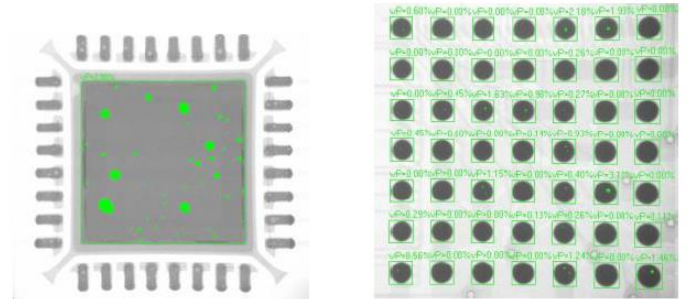
描述

V9免洗焊锡膏在BGA、BTC和LED焊接应用时近乎无空洞。所有表面处理（包括ENIG、ImSn和OSP）均可显著减少空洞。V9在印刷超微间距器件时可表现出超过12个小时的稳定性能。V9焊后残留物易于探针检测，具有高绝缘阻抗。

特性



*无铅合金.



操作和储存

参数	时间	温度
冷藏密封保质期	6个月	0°C-12°C (32°F-55°F)
密封未冷藏保质期	1个月	<25°C (<77°F)

请勿将使用过的焊锡膏添加到未使用过的焊锡膏中。使用过的锡膏与未使用过的焊锡膏分开储存；使用过的应分开存放；使用内塞或盖子将未使用的膏体密封。开封后的焊锡膏保质期取决于环境和应用，详情请见 AIM 焊锡膏使用指导。合金的成分和贮存条件可能会影响保质期。请参阅 V9 分析证书中的特定信息。

清洗

回流焊前：AIM 钢网清洗剂能在生产过程中有效去除钢网上的焊锡膏。该清洗剂可手动涂抹，或用于钢网底部擦拭设备。它不会使焊锡膏变干，且能提升焊锡膏的印刷性能。请勿过量涂抹钢网清洗剂，亦不可将其涂抹于钢网顶部。不推荐在生产过程中使用异丙醇（IPA），但其可作为钢网的最终漂洗剂。

回流焊后助焊剂残留：回流焊后，残留物可保留在元件上，无需清洗。在必须清洗的情况下，AIM已与行业伙伴紧密合作，确保常用去焊剂能有效去除这些残留物。请联系 AIM获取清洗信息

*所有信息仅供参考。不作为特定来料产品规格说明或工艺设计。有关特定产品的信息，请参阅分析证书。

免责声明 以上信息免费提供，产品信息根据正确的处理和操作条件提供。如未按信息中的正确方法使用或未按指定材料生产，造成的损失或伤害，不在责任承担范围内。详情请登入 <http://www.aimsolder.com/terms-conditions> 查询AIM相关条款。




回流曲线

欲了解回流曲线图详情，请访问 <http://www.aimsolder.com/reflow-profile-supplements>，或联系AIM以获得更多信息。

印刷

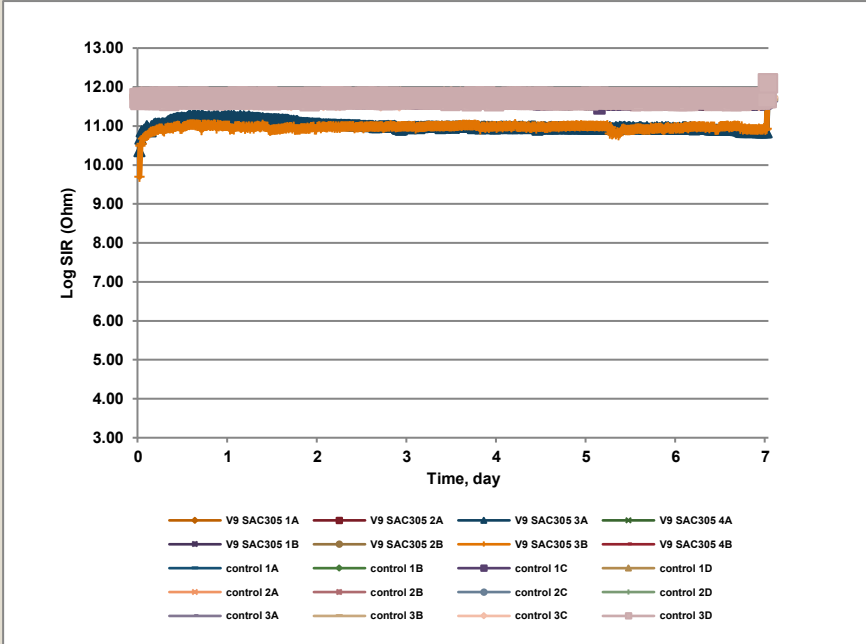
以下推荐的印刷机初始设定—取决于 PCB 和 PAD 设计	
参数	推荐初始设定
刮刀压力	0.4 - 0.7公斤/25毫米
刮刀速度	13 - 152 毫米/秒
接触距离	接触 0.00 毫米
PCB 分离距离	0.75 - 2.0 毫米
PCB 分离速度	3 - 20 毫米/秒

测试数据总结

名称	测试方法	结果	
助焊剂IPC 分类	J-STD-004A	ROL0	
助焊剂IPC 分类	J-STD-004当前版本	ROL1	
名称	测试方法	典型值	图片
铜镜	J-STD-004B 3.4.1.1 IPC-TM-650 2.3.32	低	
腐蚀性	J-STD-004B 3.4.1.2 IPC-TM-650 2.6.15	通过	
定量卤化物	J-STD-004B 3.4.1.3 IPC-TM-650 2.3.28.1	Br: 0.44% Cl: 0.0% 典型值	
定量卤化物、铬酸银	J-STD-004B 3.5.1.1 IPC-TM-650 2.3.33	通过	
定量卤化物、氟化点	J-STD-004B 3.5.1.2 IPC-TM-650 2.3.35.1	无氟化物	


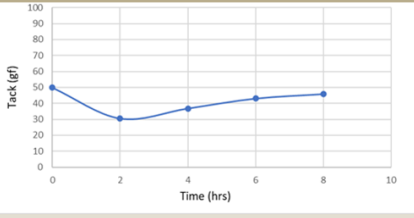
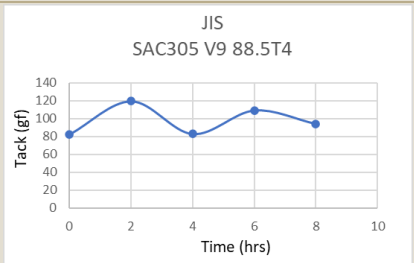
*所有信息仅供参考。不作为特定来料产品规格说明或工艺设计。有关特定产品的信息，请参阅分析证书。

免责声明 以上信息免费提供，产品信息根据正确的处理和操作条件提供。如未按信息中的正确方法使用或未按指定材料生产，造成的损失或伤害，不在责任承担范围内。详情请登入 <http://www.aimsolder.com/terms-conditions> 查询AIM相关条款。

名称	测试方法	典型值	图片
表面绝缘电阻	J-STD-004B 3.4.1.4 IPC-TM-650 2.6.3.7	所有测试模板上的测量都超过 100 MΩ	
助焊剂固体含量、非挥发性测定	J-STD-004B 3.4.2.1 IPC-TM-650 2.3.34	94.14% 典型值	
酸值测定	J-STD-004B 3.4.2.2 IPC-TM-650 2.3.13	139.03mgKOH/g 典型值	
粘度 (Malcom)	J-STD-005A 3.5.1 IPC-TM-650 2.4.34	150-250 Pa·s 典型值	
外观	J-STD-004B 3.4.2.5	通过	
坍塌	J-STD-005A 3.6 IPC-TM-650 2.4.35	通过	
润湿测试	J-STD-004B 3.7.2 IPC-TM-650 2.4.46	通过	

*所有信息仅供参考。不作为特定来料产品规格说明或工艺设计。有关特定产品的信息，请参阅分析证书。

免责声明 以上信息免费提供，产品信息根据正确的处理和操作条件提供。如未按信息中的正确方法使用或未按指定材料生产，造成的损失或伤害，不在责任承担范围内。详情请登入 <http://www.aimsolder.com/terms-conditions> 查询AIM相关条款。

锡球	J-STD-005A 3.7 IPC-TM-650 2.4.43	通过	 <p style="text-align: center;">15 分钟 4 小时</p>
粘性	J-STD-005A 3.8 IPC-TM-650 2.4.44	36.1 gf Time 0 典型值	 <p style="text-align: center;">Tack (gf)</p> <p style="text-align: center;">Time (hrs)</p>
粘性	JIS Z 3284 Annex 9	82.5 gf Time 0 典型值	 <p style="text-align: center;">JIS SAC305 V9 88.5T4</p> <p style="text-align: center;">Tack (gf)</p> <p style="text-align: center;">Time (hrs)</p>

*所有信息仅供参考。不作为特定来料产品规格说明或工艺设计。有关特定产品的信息，请参阅分析证书。

免责声明 以上信息免费提供，产品信息根据正确的处理和操作条件提供。如未按信息中的正确方法使用或未指定材料生产，造成的损失或伤害，不在责任承担范围内。详情请登入 <http://www.aimsolder.com/terms-conditions> 查询AIM相关条款。